

技术条款响应一览表

功能	总体要求： 1. 可实现对大口径晶体（KDP、DKDP）坯料体缺陷的自动化图像采集、数据处理及结果统计；支持对已知缺陷的复位分析。 2. 功能及技术指标至少包含以下内容。		
	1	测量对象范围：倍频晶体 KDP、DKDP（I 类及 II 类切割）	
	2	可分类识别气泡丝、团簇	
	3	可区分缺陷本体及重影	
	4	配置高效过滤器及遮光罩模块，实现检测舱内洁净度 ISO5 级；具备整套系统遮光功能。	
技术指标	1	检测灵敏度	$\leq 10 \mu m$
	2	检测误差	$\leq 6 \mu m + A/10$ (A 为待测缺陷尺寸)
	3	检测口径	$\geq 600mm$ (长度) $\times 600mm$ (宽度) $\times 40mm$ (厚度)
	4	横向定位误差	$\leq 0.1mm$
	5	深度定位误差	$\leq 3mm$
	6	扫描重复定位精度	不大于 $5 \mu m$
	7	激光照明光束	可见光，发散角 $\leq 1.5 \text{ mrad}$ ，均匀性 $\geq 84\%$
	8	激光照明口径	呈矩形分布，长度 $\geq 80mm$ ；宽度范围覆盖 $1 \text{ mm} \sim 5 \text{ mm}$ 且可调节；